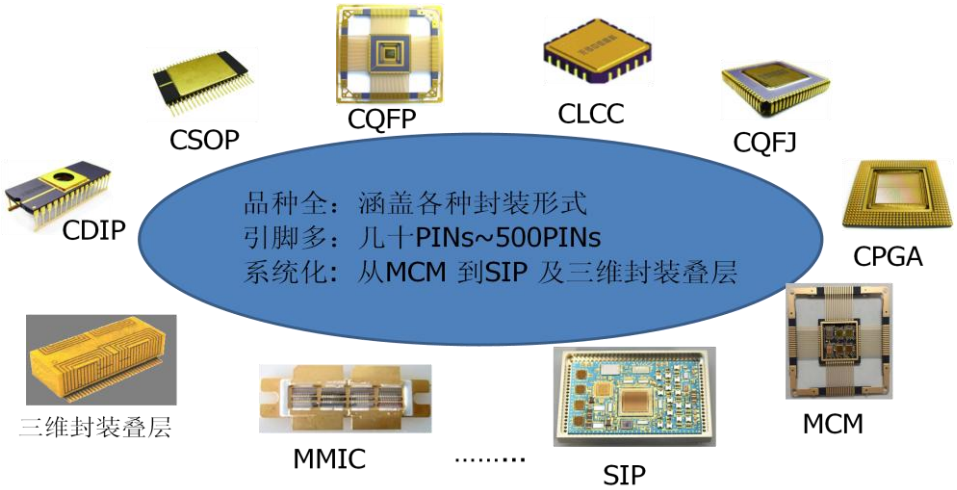
封装

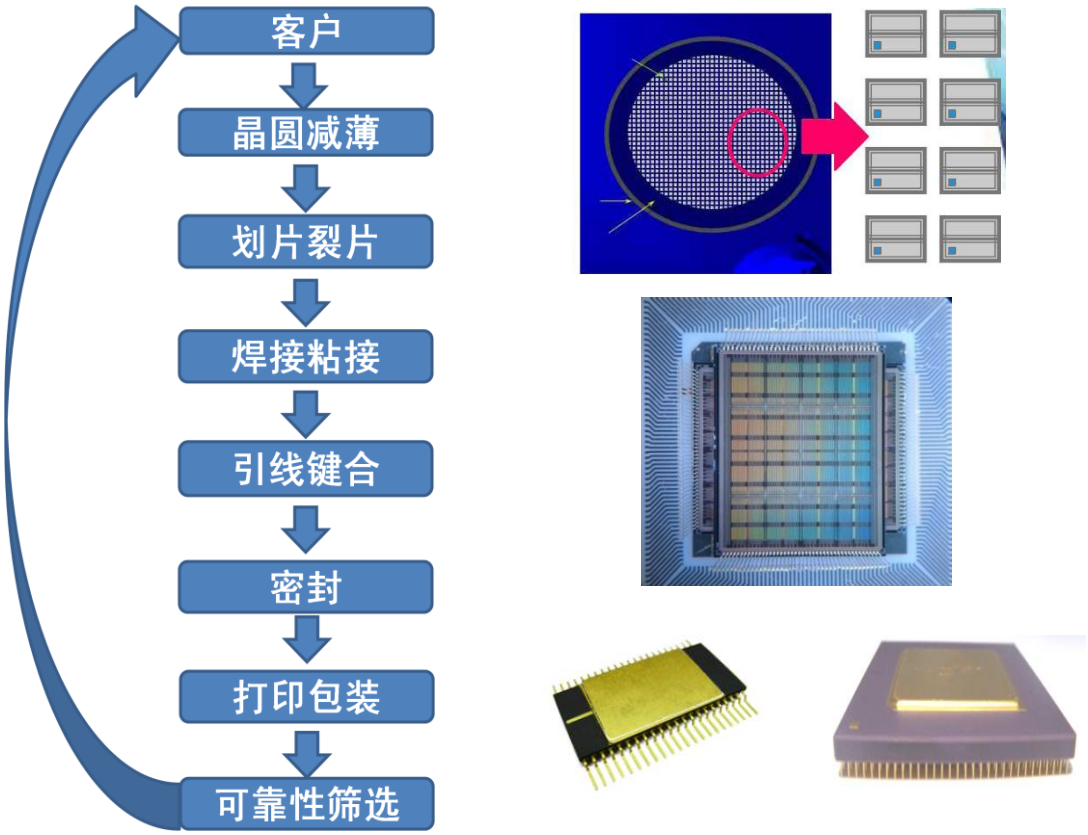
军用集成电路封装服务

西安微电子技术研究所军用集成电路封装线位于长安科技产业园区计混大楼，拥有 10000 级净化厂房 10000 平方米。具备完整的晶圆减薄、划片、背面金属化、芯片分选、贴片、键合、密封、测试及老炼试验条件。生产线配套关键工艺设备 100 余套，拥有 60 余名专业封装工艺师以及 150 余名操作人员，每年为各军工单位提供军品半导体集成电路 50 余万只。

- **陶瓷载体设计封装能力**



- **封装流程**


客户
晶圆减薄
划片裂片
焊接粘接
引线键合
密封
打印包装
可靠性筛选

DIP 系列

DIP8：8 管脚双列直插式元器件

DIP14：14 管脚双列直插式元器件

DIP16：16 管脚双列直插式元器件

DIP18：18 管脚双列直插式元器件

SKDIP28：28 管脚收缩型双列直插式元器件

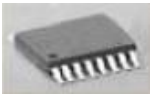
DIP40：40 管脚双列直插式元器件

SOP 系列

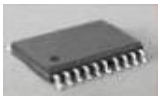
SOP8：8 管脚小尺寸封装元器件

SOP14：14 管脚小尺寸封装元器件

SOP16：16 管脚小尺寸封装元器件



SOP20：20 管脚小尺寸封装元器件



SOP24：24 管脚小尺寸封装元器件

SOP28：28 管脚小尺寸封装元器件

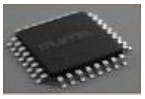
SSOP20：20 管脚缩小型小尺寸封装元器件

SSOP24：24 管脚缩小型小尺寸封装元器件

HSOP28:28 管脚带散热片小尺寸封装元器件

LQFP 系列

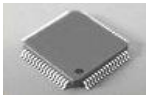
LQFP32：32 管脚薄型四边扁平封装元器件



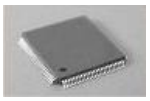
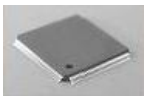
LQFP 44：44 管脚薄型四边扁平封装元器件

LQFP 48：48 管脚薄型四边扁平封装元器件

LQFP 64：64 管脚薄型四边扁平封装元器件



LQFP 100：100 管脚薄型四边扁平封装元器件



LQFP 128：128 管脚薄型四边扁平封装元器件